

# 平成21年7月期 第2四半期決算説明資料

# SANNO

## 株式会社 山王

～貴金属表面処理加工分野のリーディングカンパニー～

平成21年3月19日

▶ 決算概要と見通し

- 平成21年7月期 第2四半期業績
- 平成21年7月期 通期見通し

▶ 成長戦略と事業の方向性

▶ ご参考(会社概要等)

# 平成21年7月期 第2四半期決算

▶ 売上高： 想定外の大大幅減収で44億円(△33.0%)

▶ 営業利益、上半期純利益： 全て計画比下回る

(単位:百万円)

	H20/7 1-2Q		H21/7 1-2Q				
		構成比(%)		構成比(%)	前年同期比(%)	計画	計画比
売上高	6,631	100.0	4,446	100.0	△33.0	5,074	△627
営業利益	546	8.3	△622	—	—	△276	△345
経常利益	502	7.6	△593	—	—	△232	△360
1-2Q 純利益	244	3.7	△1,758	—	—	△373	△1,384

# 平成21年7月期 第2四半期決算ポイント

▶ 電子部品関連需要が大幅に減少 ⇒ 減収(△33.0%)

## 国内

- ▶ 最終ユーザの電子部品需要が急速に減退
  - ▶ 売上:大幅減収、営業利益:大幅減収で営業赤字
  - ▶ 売上単価は維持(減収の主な理由は数量減)
    - 顧客の当社めっき技術への高い評価は維持

## 海外

- ▶ 2Qまでは世界経済不況の影響は軽微にとどまる
  - ▶ フィリピン・中国ともに連結対象期間にタイム・ラグあり

▶ 材料高は年初に比べピークアウトし1・2Qの影響は軽微

- ▶ 材料使用量の効率化が奏功、原価への影響は想定範囲内

# 収益性： コストコントロールは適切に実施したが・・・

▶ 材料高 ⇒ 売上原価率+15%（実績・計画比は減少）

▶ 「原価低減活動」が奏功、原価上昇トレンドを抑制

▶ 販売管理費は実質減少（貸倒引当金繰入額除く）

（単位：百万円）

	H20/7 1-2Q		H21/7 1-2Q				
		構成比(%)		構成比(%)	前年同期比(%)	計画	計画比(%)
売上高	6,631	100.0	4,446	100.0	△33.0	5,074	△12.4
売上原価	5,205	78.5	4,158	93.5	△20.1	4,487	△7.4
売上総利益	1,426	21.5	288	6.5	△79.7	586	△50.9
販管費	879	13.2	910	20.5	+3.5	862	+5.5
営業利益	546	8.3	△622	—	—	△276	—

貸倒引当金繰入73百万円含む

# 事業別売上高

▶ 構成比に大きな変化はなし

▶ 顧客囲い込み(精密プレス⇒表面処理)は、一服感

(単位:百万円)

	H20/7 1-2Q		H21/7 1-2Q			
		構成比(%)		構成比(%)	増減額	前年同期比(%)
表面処理加工	6,072	91.6	4,094	92.1	△1,978	△32.6
精密プレス加工	559	8.4	352	7.9	△207	△37.0
合計	6,631	100.0	4,446	100.0	△2,185	△33.0

# 事業の状況

- ▶ 景気後退で2Qから国内めっき需要が急減
- ▶ 大口顧客の構成比率は変化ないものの(上位5社で約6割) 大幅な受注減少⇒市場全体が縮小したものと推定

**表面処理加工  $\Delta 32.6\%$**

\*数字は対前年同期比

- ▶ 国内主要取引先からの受注が2Qから急減
  - ▶ 電子部品メーカーの最終ユーザーの需要が急激に縮小
- ▶ 海外では、2Qまでは金融危機の影響は軽微で順調に推移

**精密プレス加工  $\Delta 37.0\%$**

- ▶ 需要減と取引先コストダウンの影響受け売上ダウン
- ▶ プレス加工⇒表面処理加工一貫体制の需要停滞も影響

# キャッシュ・フローの状況

▶ 現預金の2Q期末残高は36億7800万円

▶ 投資活動キャッシュ・フローは預金へ振替(6億円)を含む

(単位:百万円)

	H20/7 1-2Q	H21/7 1-2Q	増減額
現金・現金同等物 期首残高	4,192	3,868	△324
営業活動キャッシュ・フロー	910	1,173	+263
投資活動キャッシュ・フロー	△494	△939	△445
フリー・キャッシュ・フロー	416	233	△183
財務活動キャッシュ・フロー	651	△328	△979
現金・現金同等物 期末残高	5,107	3,678	△1,429

# バランス・シートの状況

▶ 自己資本比率は65.7%(平成21年1月末現在)

▶ 純資産額約100億円(同上)

(単位:百万円)

	H20/7 末	構成比 (%)	H21/7 2Q末	構成比 (%)	増減額
株主資本	11,993	96.2	10,174	—	△1,819
資本金・ 資本剰余金	1,833	14.7	1,833	—	0
利益剰余金	10,160	81.5	8,341	—	△1,819
評価換算価 額	469	3.8	△189	—	△658
純資産合計	12,462	100.0	9,984	100.0	△2,478
自己資本 比	—	68.2	—	65.7	—

# 平成21年7月期通期見通し

- ▶ 売上高：通期にわたって需要停滞は続く(△48.2%)
- ▶ 大幅減収で営業赤字を見込む
- ▶ 減損会計、繰延税金資産取崩し等で大幅な純損失計上へ

(単位:百万円)

	H20/7・実績		H21/7・計画			
		構成比 (%)		構成比 (%)	前期比 (%)	差異
売上高	12,642	100.0	6,548	100.0	△48.2	△6,094
営業利益	731	5.8	△1,608	—	—	△2,339
経常利益	679	5.4	△1,534	—	—	△2,213
当期純利益	537	4.3	△2,695	—	—	△3,232

# 平成21年7月期 売上高見通し詳細

## ▶ 需要減で構成比に大きな変化なし

事業別売上高	H20/7・実績		H21/7・計画（単位：百万円）			
		構成比(%)		構成比(%)	増減額	前年同期比(%)
表面処理加工	11,641	92.1	6,048	92.4	△5,593	△48.0
精密プレス加工	1,000	7.9	499	7.6	△501	△50.1
合計	12,642	100.0	6,548	100.0	△6,094	△48.2

## ▶ 海外は、3Q・4Qは世界経済の低迷を想定

地域別売上高	H20/7・実績		H21/7・計画（単位：百万円）			
		構成比(%)		構成比(%)	増減額	前年同期比(%)
国内	7,820	61.9	4,299	66.7	△3,521	△45.1
海外	4,822	38.1	2,249	34.3	△2,573	△53.4

# 海外事業： 3Q以降は世界不況の影響を受ける見通し

▶ 今期売上見通し 22億円（前期比△53.4%）

▶ 世界的な携帯電話等の在庫滞留の影響受けニーズ急減

中国 1,213百万円(同△58.8%)



▶ 携帯電話など電子部品需要が急減

フィリピン 1,035百万円(同△38.8%)



- ▶ 当面は既存顧客との量産品取引も厳しい模様
- ▶ 生産コスト安く、「中国+1」政策の拠点として重要性変化せず

# 設備投資・減価償却費・研究開発費計画

▶ **設備投資額** 通期は当初想定以上に設備投資を抑制

▶ 既存設備の更新関連投資が中心

▶ **研究開発費** 不況時でも製品・工程改善へ投資を継続

▶ 引き続き新工法(部分めっき等)への投資を予定

(単位:百万円)

	H20/7実績	H21/7計画	差異	前期比
設備投資額	488	301	△187	△38.3%
減価償却費	1,241	1,124	△117	△9.4%
研究開発費	269	181	△88	△32.7%

# 中間配当75円は実施

- ▶ 平成21年7月期中間配当:75円は予定どおり実施
- ▶ 平成21年7月期期末配当:内部留保優先で無配を予定

(単位:円)

	H20/7実績	H21/7計画
通 期	200	75
中 間	75	75
期 末	125	0
配 当 性 向	18.1%	—%

▶ 決算概要と見通し

- 平成21年7月期 第2四半期業績
- 平成22年7月期 通期見通し

▶ 成長戦略と事業の方向性

▶ ご参考(会社概要等)

# 平成21年7月期通期へ向けた状況と施策

## 1. 原材料高騰の影響は最小限になる見込み

- ▶ 原価低減活動は、引き続き実施(材料使用量減少＋再利用促進)

## 2. 当然ながら固定費削減に注力

- ▶ 業務効率化の推進(合理化策の実施)

## 3. 既存顧客との関係を緊密化

- ▶ 品質と納期を更に改善し、顧客信頼性を向上

## 4. 取引関係のモニタリング強化

- ▶ 債権の保全

# 危機感ある事業環境だが……

## ▶ 危機感①： 既存電子部品の需要が大幅に縮小している

- ・世界的金融危機が電機製品⇒電子部品の需要を直撃
- ・めっき市場も大幅に需要が縮小
- ・主要ユーザーが最終需要の減少を受け、弊社への発注を大幅に減少

## ▶ 危機感②： 顧客が内製化を進めている

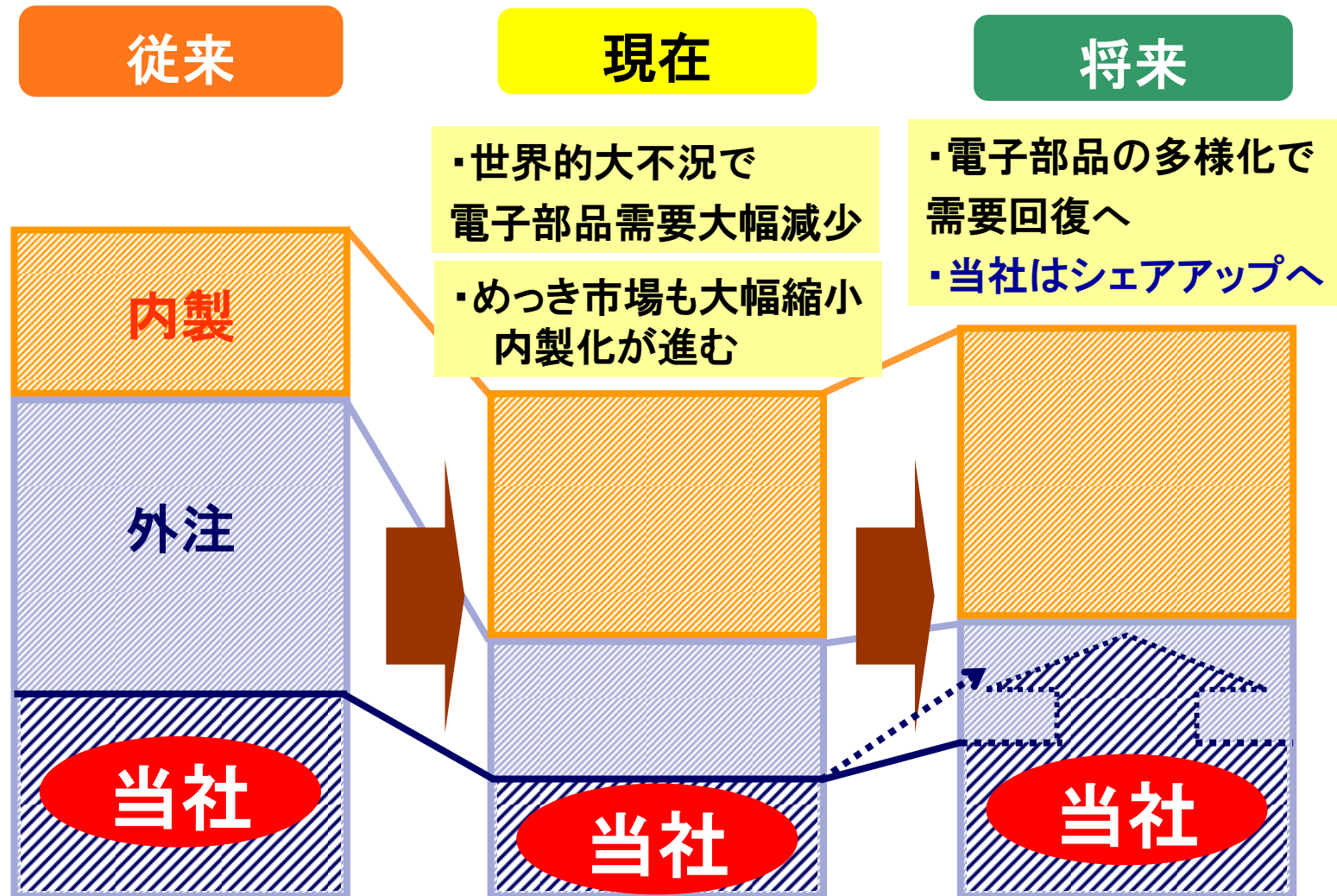
- ・コストダウンで主要ユーザーでの内製化もすすむ
- ・外注市場は縮小傾向だが、当社はシェアアップで乗り切る方針



しかし、不況は千載一遇のチャンスである

# 事業拡大イメージ:

## ▶ 外注市場でのシェアアップをめざす



# 基本戦略＝営業強化に重点

## ▶ 営業体制の強化が事業拡大につながる

### 事業の拡大

#### 営業戦略

- ・既存コネクタメーカー150社との取引深耕
- ・営業部門と技術部門の連携共同営業の強化

#### 海外戦略

- ・中長期的な円高基調を踏まえた生産拠点の移転

+

### 内部体制(企業体質)強化

#### 事業基盤

技術改良の推進

#### 収益基盤

生産の効率化(原価低減活動)

#### 組織体制

工場・管理部門の効率化

# 事業・顧客基盤拡大のための営業戦略

## ▶ コネクターメーカー150社との取引深耕＋顧客層の拡大

### 技術セクションと連携した顧客サービス・営業活動の充実

- 顧客囲い込み(プレス・めっき一貫加工体制の強化)
  - ・ ⇒ 前提としての金型設計能力の強化
- 既存主要顧客に囚われない販売ルートの開拓

### 顧客の弊社への評価

#### 企業としての信頼感＋製品・サービスに対する信頼感

A社・・会社としての体力、製品の品質・納期が優れているので、  
外注は山王さんにこれからもお願いしたい。

B社・・製品の品質だけでなく、トラブル発生時の迅速な対応など  
アフターケア・メンテナンスで信頼している。

# 付加価値を高める：山王のQCDS

**Quality**

競合他社より優れた品質での  
量産化

**Cost**

金材料費の削減、仕様変更等の  
VA(付加価値)提案でコスト対応

**Delivery**

受注から納品まで  
一貫した生産管理システム開発

**Service**

高い技術力による  
高付加価値化

# 技術開発の最新状況

## ▶ 「高密度・高細度加工技術」の開発

- ▶ 電子部品の高機能化・小型化への対応
- ▶ ニッケルバリアの進化(第2世代開発)は試作品提供へ
  - ▶ 多様なニーズに応えるために各種パターンを想定

## ▶ 「製造プロセス」の変化促進（改善⇒効率化⇒革新）

- ▶ 原材料使用量がさらに減少する工法の開発  
⇒恒久的な材料価格(金など)高騰・省資源化対策として  
「製造プロセス」そのものを見直す方向

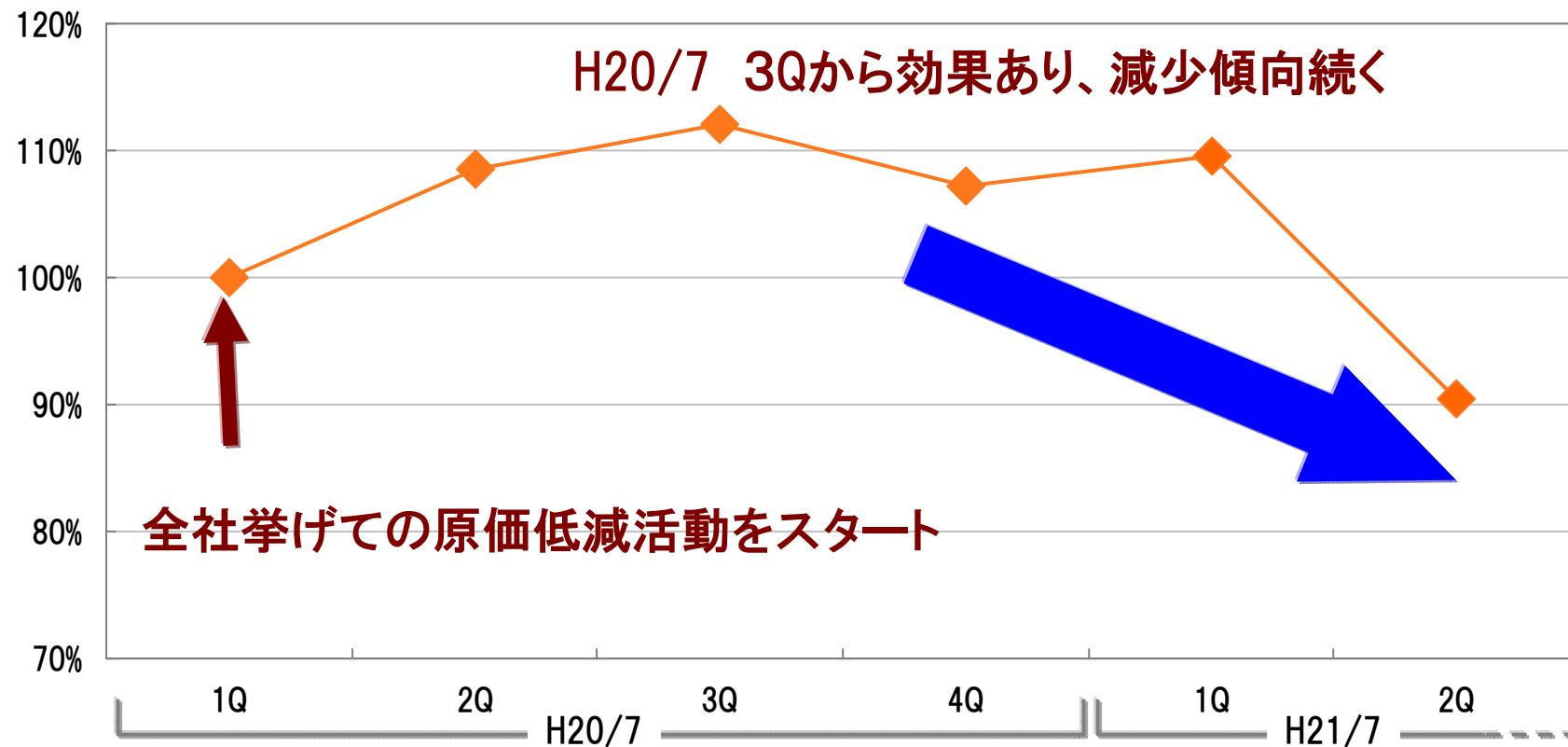
# 原価低減活動は順調にすすんでいる

## ▶ (例)金消費量を効率化する工法を実現

▶ 金価格ほか長期的に高騰が想定される原材料の調達対策

H20/7 1Q=100とする

### 材料費比率の推移 (国内・めっき)



# 金型設計能力は強化されつつある

## ▶ プレス・めっき一貫加工体制の確立による顧客囲い込み

▶ 金型設計能力⇒プレス・めっき一貫加工体制へのカギ

▶ 特別設計・製作チーム(現場スタッフから選抜)が研鑽中



# 工場再編などで組織を効率化

## ▶ 組織の再編

### ▶ 工場

- 稼働率向上へ国内工場を再編(業務の集約)
- 国内と海外工場の位置づけを明確化
  - 国内……マザー工場
  - 中国・フィリピン……汎用品の生産体制を強化・品質も向上へ

### ▶ 管理部門

- 昨夏以降、新システム稼働で情報共有・業務効率化すすむ

## ▶ 人事戦略

### ▶ 権限委譲

- 役員相互の連携強化 ⇒ 意志決定のスピード化

### ▶ 研修強化

- 工場で技術勉強会を実施

# 海外事業は中長期拡大に変更なし

短期

生産ライン稼働率の維持・更新に注力

▶ 世界的な景気回復は短期的に期待薄

▶ 中国の需要は回復の兆し(経済対策が奏功)

平成21年7月期業績見通しへの影響は織込済

中長期

予定通り生産ライン増設・生産能力拡充

▶ 中国・フィリピンの生産拠点は拡大基調に変化なし

アジアは電子部品・半導体の「世界の工場」

▶ 付加価値高いニッケルバリア加工進出も視野

ニッケルバリア加工はアジアでの地位強化・拡大に不可欠

▶ご参考(会社概要その他)

# 株式会社山王(サンノー)

## 表面処理加工＋精密プレス加工

**事業内容** : 電子部品を対象とした貴金属表面処理加工・精密プレス加工、  
金型設計・製作

**創業** : 昭和33年8月

**代表者** : 代表取締役社長 荒巻 芳幸

**所在地** : 本社:神奈川県横浜市港北区綱島東

**資本金** : 9億6,220万円(平成20年7月末現在)

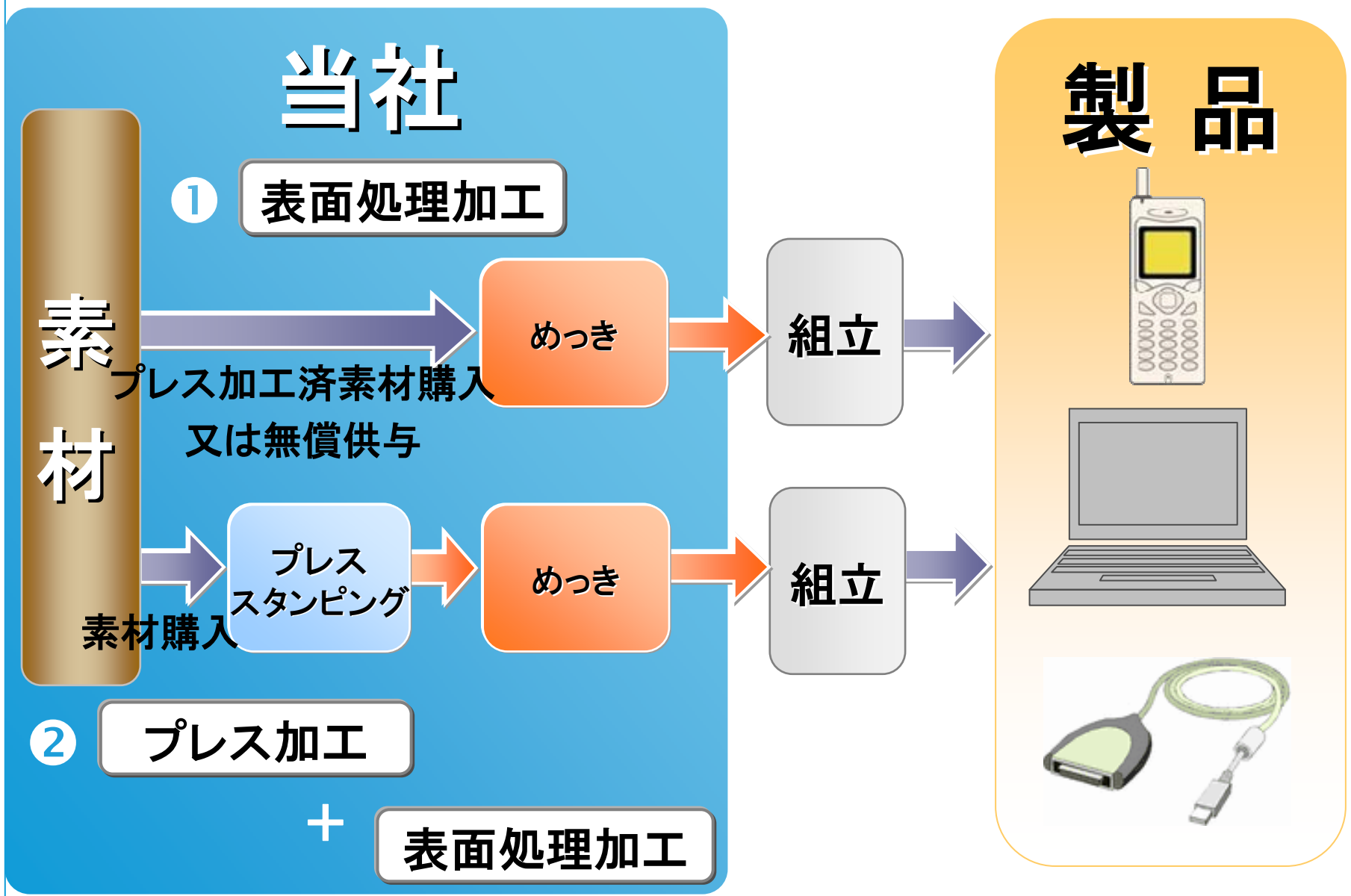
**売上高** : 126億42百万円(平成20年7月期)  
( 連 結 )

**経常利益** : 6億79百万円(同上)  
( 連 結 )

**事業拠点** : 日本・中国・フィリピン

**従業員数** : 726名(正社員＋準社員・パート含む)(平成20年7月末現在)  
( 連 結 )

# ビジネスモデル: ①表面処理加工 又は ②プレス加工+表面処理加工



# 当社コア技術： 表面処理＋めっき加工

## 表面処理技術

「金めっき」によるウイスキー対策

「金めっき」を補強するニッケルバリア加工

当社は、  
**「業界のさきがけ」**  
として開発

## めっき加工技術

リールtoリールの表面処理加工

FFCのロールtoロール加工

# 当社コア技術＝表面処理が求められる理由

## ■ 素材(金属)の性能を高める

### 通電性

電子部品には、半永久的に電気の流れが良いことが求められ、そのため「金めっき」が施される。

### 耐食性

金属にはサビ(酸化)が発生。サビには金が最も強いため、「金めっき」が、さらに性能向上の為に、「後処理(防錆処理)」が施される。

### 半田付性

電子部品をボードに実装する場合に、半田(鉛フリー)を活用。その際、ピンに「金めっき」または「半田めっき」されていると、スムーズかつ強固な装着が可能。

### 挿抜性

コネクタを接続する際にスムーズに挿入、抜去ができる方法として、「金めっき」及び「後処理」が最適。

# 多様な製品に利用される表面処理加工

## ■ 用途別

### パソコン関係



デスクトップパソコン、  
ノートパソコン、  
他プリンター等の周辺機器

### 携帯端末



携帯電話の搭載品、  
バッテリー関係の周辺機器

### 車載



自動車の制御部分・  
計器類及びエアバック等、  
カーナビ装置等の機器類

### カード



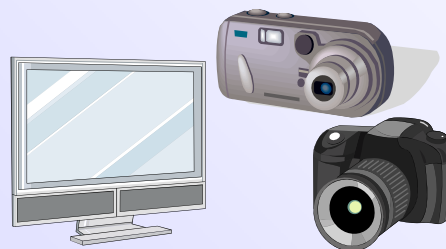
カード用のソケット・  
メモリーカード等の記憶装置、  
ICカード等の機器

### ゲーム機器



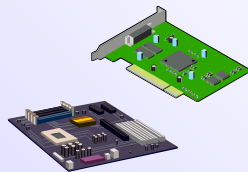
パチンコ等アミューズメント機器、  
家庭用ゲーム機等

### デジタル家電



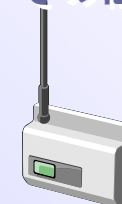
デジタルカメラ、  
デジタルテレビ、DVD等

### 半導体設備



ICソケット、  
バーイン用ソケット等

### その他



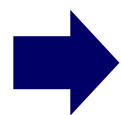
基地局等の通信機  
モバイル及び  
上記に分類されない機器・装置等

# 国内外バランスのとれた当社の事業

## ▶ 表面処理加工・高付加価値処理のソリューション

国内

高付加価値処理  
(ニッケルバリア加工)

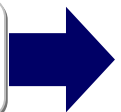


国内電子部品メーカー

## ▶ 顧客の海外進出ニーズへのソリューション

海外

海外進出への対応力



日系電子部品メーカー



顧客囲い込み

現地電子部品メーカー

プレ ス 加 工 処 理

# 国内外事業拠点

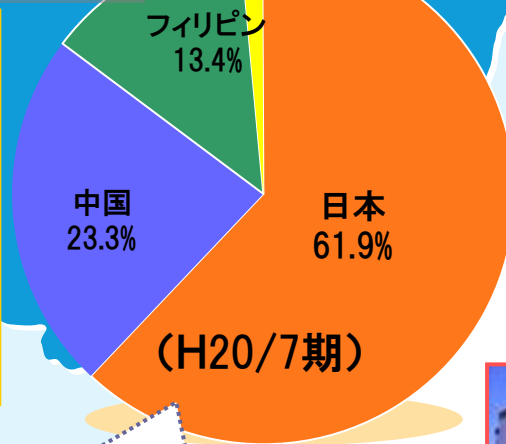
山王電子(中国・無錫)



海外売上高比率:38.1%  
(平成20/7期)

地域別売上高の内訳

SPMC(フィリピン)



東北第二工場



東北工場



秦野工場



鈴川工場



本社・横浜工場



H21/7期(1-2Q)

日本57.9% / 海外42.1%

H20/7期

日本61.9% / 海外38.1%

H19/7期

日本67.0% / 海外33.0%

本資料は、当社の事業及び業界動向について当社による現在の予定、推定、見込み又は予想に基づいた将来の展望についても言及しています。

これらの将来の展望に関する表明は、様々なリスクや不確かさが伴っています。既に知られた、もしくははまだ知られていないリスク、不確かさその他の要因が、将来の展望に対する表明に含まれる事柄と異なる結果を引き起こさないとも限りません。当社は、将来の展望に対する表明、予想が正しいと約束することはできず、結果は将来の展望と著しく異なることもありえます。

本資料における将来の展望に関する表明は、平成21年3月19日現在において利用可能な情報に基づいて、当社により平成21年3月19日現在においてなされたものであり、将来の出来事や状況を反映して将来の展望に関するいかなる表明の記載をも更新し、変更するものではありません。

平成21年3月

株式会社山王

平成21年7月期 第2四半期決算説明資料